深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-012

投资者关系活动类别	√特定对象调研　□分析师会议　□媒体采访 □业绩说明会　□新闻发布会　□路演活动 □现场参观　□电话会议　□其他
参与单位名称及人员姓名	中信建投、宝盈基金、平安基金
时间	2026 年 10 月 27 日(周二) 10:30-11:30
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春

投资者关系活动主要内容介绍	**1、如何看待公司主控芯片的技术能力？主控芯片能力如何影响公司端侧AI领域的竞争力？如何看待端侧AI存储方案未来的市场应用前景？** 答：公司自2020年起，高起点布局主控芯片研发，核心研发团队具备多代旗舰主控芯片开发经验，目前已形成跨越多代协议、覆盖多种产品形态的自主芯片研发能力。公司围绕嵌入式存储、固态硬盘和移动存储等领域，构建了十余款主控芯片的研发序列，覆盖UFS、SSD、eMMC、SD卡及USB等NAND Flash主要存储应用形态。公司主控芯片采用5nm至28nm的制程工艺，领先于行业主流主控产品，通过芯片架构与固件的协同优化，使搭载相应主控的存储产品在性能、功耗与可靠性等方面形成差异化优势。相关主控芯片面向高端智能手机、AI PC、智能汽车、工业控制等广泛应用场景，为公司向具备自主芯片设计能力的综合型半导体存储品牌企业转型升级提供核心支撑。 公司多年来持续投入主控芯片自主研发，相关成果已逐步落地，为端侧AI存储业务奠定了坚实基础，并在该领域形成了涵盖主控芯片、软件架构与生态适配的综合先发优势。公司自主研发设计的SPU芯片与UFS 4.1主控芯片，采用全球领先的制程工艺，搭配面向端侧AI的存储智能调度引擎和高级缓存技术，能够减少大模型对DRAM的持续占用，显著提升端侧设备可支持的大模型规模上限。 公司已与AMD、高通、紫光展锐、全志科技等众多主芯片厂商完成了端侧AI存储方案的适配工作。其中，基于和AMD的联合调优，在AI移动工作站及AI PC平台的测试数据显示，搭载公司智能软硬件架构的设备，AI PC端模型规模提高约3.2倍，内存利用效率提升约200%。基于高通与江波龙等合作伙伴的多方合作，已能够实现30B-MoE（混合专家）模型在智能手机上的完整部署。相关技术将为端侧大

	模型在普通个人用户中的大规模普及奠定重要的存储技术底座，具备极为广阔的市场应用前景。公司正与重要合作伙伴一道，推进相关技术的产品化和市场推广。 **2、公司未来的采购策略将如何变化？** 答：在当前存储晶圆价格处于高位的背景下，公司高度重视经营质量，结合存储行业情况以及产品特点、客户结构等自身经营特征，合理把握适合公司的生产经营节奏，适时开展备货采购，保障公司稳健经营，提高抗风险能力。2026年第三季度（7—9月），公司经营活动产生的现金流量净额已实现转正。 **3、如何看待存储价格未来变化趋势？** 答：结合第三方机构发布的信息来看，AI大模型在云端与端侧的落地应用已成为较为明确的产业趋势。尽管存储需求短期内可能受到下游终端市场波动的影响，但长期来看，AI大模型仍有望为存储行业带来持续的需求增量。受过往行业周期波动影响，海外原厂仍采取相对审慎的NAND Flash资本开支策略，更多通过技术升级推动NAND Flash供给温和增长，因此存储产业供需关系仍将维持偏紧态势。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无